

# Kupferbad SLOTOCOUP CU 210

Das Kupferbad SLOTOCOUP CU 210 ermöglicht in Kombination mit Reverse Pulse Plating eine ausgezeichnete Metallverteilung in Durchgangsbohrungen. Die erhaltenen Kupferüberzüge sind feinkörnig und duktil. Da höhere mittlere Stromdichten als bei Gleichstromabscheidung möglich sind, kann eine erhebliche Verkürzung der Galvanisierzeit bei gleichzeitig exzellenter Metallverteilung erreicht werden.

Ansatz und Betrieb des Elektrolyten erfolgen mit zwei Zusätzen.

Kupferbad SLOTOCOUP CU 210 kann auch mit Gleichstrom betrieben werden und liefert dann glänzende, feinkörnige und duktile Kupferniederschläge.

Die Angaben in der Gebrauchsanleitung basieren auf unseren Labor- und Praxiserfahrungen. Da Ergänzungsmengen und Eingriffsgrenzen in Abhängigkeit von Materialart und -geometrie, deren Anwendung und der Anlagentechnik ggf. von den Angaben in der Gebrauchsanleitung abweichen können, sind diese Angaben nicht bindend.

## Wichtiger Hinweis!

Wir bitten, diese Gebrauchsanweisung vor Einsatz des Verfahrens sorgfältig zu lesen und alle die Arbeitsweise beeinflussenden Parameter zu beachten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Im Interesse der eigenen Sicherheit beachten Sie bitte unbedingt die Gefahrenhinweise auf den Etiketten der Gebinde. Die Mindesthaltbarkeit der Produkte kann ebenfalls den Gebindeetiketten oder dem entsprechenden Qualitätszertifikat (QA03) entnommen werden.

Die aktuelle IMDS-Nummer für die aus dem Verfahren abgeschiedene Schicht kann im Internet unter [www.schloetter.de/downloads](http://www.schloetter.de/downloads) eingesehen werden.

Für die Lagerung von chemischen Produkten ist die TRGS 510 maßgebend.

